

# Reflow Ofen RK360



- **Reflow Ofen RK360**
- **Technische Daten**
- **Bleifrei geeignet**
- ja
- **Heizflächengröße**
- max. 330 x 220 mm
- **Leiterplatten Höhe**
- max. 35 mm
- **Lötprozessprogrammierung**
- Lötprofil frei programmierbar [Temp=f(t) mit 20 Sequenzen ]
- Programmablauf automatisch
- **Wärme Verteilung**
- Infrarot + Heissluft Zwangszirkulation
- **Arbeits-Temperaturbereich**
- 30 - 300 °C
- **Lötprozessdauer**
- ca. 4 - 5Min. für PCB 300x200mm
- **Anschlussleistung**
- max. 3500 W
- **Eigenschaften des Reflowofens**
- Energiesparendes system - optimale Kosten
- 3 Profile speicherbar
- geeignet für beidseitiges Löten der Flachbaugruppe
- duales Zirkulationssystem für schnelles Abkühlen der Leiterplatte
- Innenbeleuchtung zur Beobachtung des Lötprozesses
- **Netzanschluß**
- 220 VAC - 50/60Hz
- **Maße und Gewichte**
- 565 x 600 x 500mm / ca.50 kg